

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02014/157550

発行日 平成29年2月16日 (2017. 2. 16)

(43) 国際公開日 平成26年10月2日 (2014. 10. 2)

(51) Int. Cl.	F 1	テーマコード (参考)
A 6 1 N 1/04 (2006. 01)	A 6 1 N 1/04	4 C 0 5 3
A 6 1 B 5/0408 (2006. 01)	A 6 1 B 5/04 3 0 0 W	4 C 1 2 7
	A 6 1 B 5/04 3 0 0 Y	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 34 頁)

出願番号 特願2015-508711 (P2015-508711)	(71) 出願人 504157024 国立大学法人東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
(21) 国際出願番号 PCT/JP2014/058947	(74) 代理人 100090251 弁理士 森田 憲一
(22) 国際出願日 平成26年3月27日 (2014. 3. 27)	(74) 代理人 100139594 弁理士 山口 健次郎
(31) 優先権主張番号 特願2013-70450 (P2013-70450)	(74) 代理人 100185915 弁理士 長山 弘典
(32) 優先日 平成25年3月28日 (2013. 3. 28)	(72) 発明者 西澤 松彦 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 国立大学法人東北大学内
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)	Fターム(参考) 4C053 BB03 BB04 BB06 BB07 BB34 EE11 JJ40 4C127 LL22 LL24

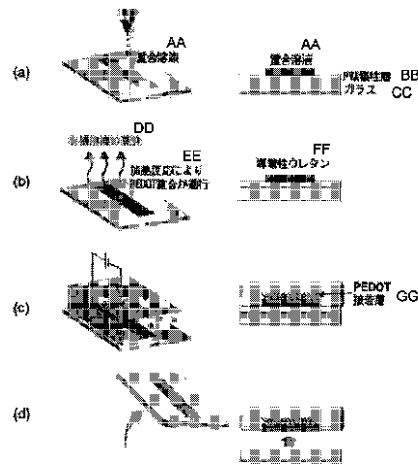
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多孔質基板電極体及びその製造方法

(57) 【要約】

本発明の目的は、ハイドロゲルを基板とする高電圧の発生が可能な電極体を提供することである。また、本発明の更なる目的は、ハイドロゲルの変形によっても、断線しない電極体を提供することである。

前記課題は、電極が、多孔質体に導電性高分子接着層によって接着している多孔質基板電極体であって、前記電極が、金属電極、伸縮性電極、及びカーボン電極からなる群から選択されることを特徴とする多孔質基板電極体によって解決することができる。



- AA Polymerization solution
- BB PVA sacrificial layer
- CC Glass
- DD Evaporation of organic solvent
- EE PEDOT polymerization proceeds by means of heating reaction
- FF Conductive urethane
- GG Adhesive layer

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電極が、多孔質体に導電性高分子接着層によって接着している多孔質基板電極体。

【請求項 2】

前記電極が、金属電極、伸縮性電極、カーボン電極及びそれらの複合材料電極からなる群から選択される 1 つ以上であることを特徴とする多孔質基板電極体。

【請求項 3】

前記電極が、金、グラファイト、又は導電性ウレタンである、請求項 1 又は 2 に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 4】

電極が多孔質体上への配設、又は多孔質体内への埋設によって、接着している請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 5】

前記電極の表面に、更に導電性高分子重合層を有する請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 6】

前記導電性高分子が、ポリ(3,4エチレンジオキシチオフェン)、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリピチオフェン、ポリイソチオフェン、ポリドデシルチオフェン、ポリイソナイトチオフェン、ポリ-3-ヘキシルチオフェン、ポリアニオン、ポリイソチアナフテン、ポリチアジル、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリジアセチレン、ポリアセン、ポリパラフェニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリフェニレスルフィドからなる群から選択される 1 つ以上の導電性高分子である、請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 7】

前記多孔質体がゲルである請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 8】

前記多孔質体がハイドロゲルである請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 9】

前記多孔質体が、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、ポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギーナンゲル、キトサンゲル、ポリNイソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、ポリスチレンスルホン酸ゲル、及びそれらの 2 つ以上の複合ゲルからなる群から選択される 1 つ以上の多孔質体である、請求項 1 ~ 8 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 10】

乾燥及び/又は滅菌された請求項 1 ~ 9 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 11】

エレクトロポレーション用である、請求項 1 ~ 10 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 12】

(1) 電極形成用基材に、電極を形成する工程、
 (2) 電極形成用基材に形成された電極に接触するように、多孔質体を形成する工程、
 (3) 導電性高分子モノマーを含む電解質液中で電解重合を行い、電極から多孔質体中に導電性高分子接着層を形成させることによって、電極と多孔質体とを接着する工程、
 (4) 電極形成用基材と、電極とを剥離する工程、
 を含む多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 13】

10

20

30

40

50

(5) 電極の表面に、導電性高分子のモノマーを含む電解質液を接触させ、電解重合により、前記電極面に導電性高分子重合層を形成する工程、を更に含む請求項12に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項14】

前記電極形成用基材がガラス板であり、そして電極が金属電極、伸縮性電極、及びカーボン電極からなる群から選択される1つ以上である、請求項12又は13に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項15】

前記電極形成用基材がガラス板であり、そして電極が金、グラファイト、又は導電性ウレタンである、請求項12～14のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項16】

前記電極形成工程(1)が、棒状の電極形成用基材の側周面に、電極を形成する工程であり、

前記多孔質体の形成工程(2)が、前記電極が形成された棒状の電極形成用基材の周囲に多孔質体を形成する工程、または前記電極が形成された棒状の電極形成用基材を多孔質体に挿入する工程である、請求項12～15のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項17】

前記導電性高分子のモノマーが、3,4エチレンジオキシチオフエン、アセチレン、ピロール、チオフエン、ピチオフエン、イソチオフエン、ドデシルチオフエン、イソナイトチオフエン、3-ヘキシルチオフエン、アニオン、イソチアナフテン、チアジル、フェニレン、フルオレン、ジアセチレン、アセン、パラフェニレン、チエニレンビニレン、及びフェニルスルフィドからなる群から選択される1つ以上のモノマーである、請求項12～16のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項18】

前記多孔質体が、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、ポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギーナンゲル、キトサンゲル、ポリNイソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、ポリスチレンスルホン酸ゲル、及びそれらの2つ以上の複合ゲルからなる群から選択される1つ以上の多孔質体である、請求項12～17のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、多孔質基板電極体及びその製造方法に関する。本発明の多孔質基板電極体は、高電圧のパルスを生じさせることができる、生体親和性の高い柔軟な電極体である。

【背景技術】

【0002】

従来、電気刺激を用いた治療機器、又は電気刺激を用いた診断機器などでは、皮膚と直接接触する電極が用いられている。また、近年、体内埋め込み式の医療機器、又は神経に信号を入力するための神経インターフェースなどの開発が進められてきており、これらに用いる細胞(神経)神経刺激用電極などの開発も行われている。更に、生体組織(細胞)に遺伝子を、直接導入するエレクトロポレーションの機器も開発されている。前記の機器に用いられる電極は、生体の組織又は細胞に、直接接触する可能性が高く、生体適合性を有する材料であることが好ましい。

【0003】

本発明者らは、生体適合性を有する電極として、基板にハイドロゲルを用いた電極を開発した。ハイドロゲルは柔軟であり、含水性及び分子拡散性が高いものが多く、細胞又は

10

20

30

40

50

組織などの生体親和性に優れている。しかしながら、ハイドロゲルなどの含水性の高い多孔質材料に、導電性の電極を直接形成することはできなかった。本発明者らは、電解重合により、ハイドロゲルを基板として、導電性高分子の電極パターンを形成させた電極を開発した（特許文献 1、非特許文献 2 及び 3）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】国際公開第 2011/118800 号

【非特許文献】

【0005】

【非特許文献 1】「ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティー（Journal of the American Chemical Society）」（米国）2010年、第 132 巻、p. 13174 - 13175

【非特許文献 2】「エイシーエス・マクロ・レターズ（ACS Macro Letters）」（米国）2012年、第 1 巻、p. 400 - 403

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本願発明者は、前記特許文献 1 及び非特許文献 1 及び 2 に記載のハイドロゲルを基板とする電極の検討を進めたところ、前記の電極は導電性高分子を電極配線材料として用いているため、抵抗が高く高電圧のパルスを発生させることが不可能であった。また、導電性高分子自体は伸縮性がなく、ハイドロゲルが変形することによって、断線してしまうことがあった。

従って、本発明の目的は、ハイドロゲルを基板とする高電圧の発生が可能な電極体を提供することである。また、本発明の更なる目的は、ハイドロゲルの変形によっても、断線しない電極体を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者は、ハイドロゲルを基板とする高電圧の発生が可能な電極体について、鋭意研究した結果、驚くべきことに、金属電極又はカーボン電極を高分子導電体の重合により多孔質体と接着させることにより、高電圧のパルスを発生することができる電極体を製造できることを見出した。また、伸縮性電極を高分子導電体の重合により多孔質体と接着させることにより、伸縮可能で、電極の断線が発生しない電極体を製造できることを見出した。

本発明は、こうした知見に基づくものである。

従って、本発明は、

[1] 電極が、多孔質体に導電性高分子接着層によって接着している多孔質基板電極体、

[2] 前記電極が、金属電極、伸縮性電極、カーボン電極及びそれらの複合材料電極からなる群から選択される 1 つ以上であることを特徴とする多孔質基板電極体、

[3] 前記電極が、金、グラファイト、又は導電性ウレタンである、[1] 又は [2] に記載の多孔質基板電極体、

[4] 電極が多孔質体上への配設、又は多孔質体内への埋設によって、接着している [1] ~ [3] のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[5] 前記電極の表面に、更に導電性高分子重合層を有する [1] ~ [4] のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[6] 前記導電性高分子が、ポリ(3,4エチレンジオキシチオフエン)、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフエン、ポリピチオフエン、ポリイソチオフエン、ポリドデシルチオフエン、ポリイソナイトチオフエン、ポリ-3-ヘキシルチオフエン、ポリアニオン、ポリイソチアナフテン、ポリチアジル、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリジアセチレン、ポリアセン、ポリパラフェニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリフェニレ

10

20

30

40

50

スルフィドからなる群から選択される1つ以上の導電性高分子である、[1]~[5]のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[7]前記多孔質体がゲルである[1]~[6]のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[8]前記多孔質体がハイドロゲルである[1]~[7]のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[9]前記多孔質体が、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、ポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギーナンゲル、キトサンゲル、ポリNイソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、ポリスチレンスルホン酸ゲル及びそれらの2つ以上の複合ゲルからなる群から選択される1つ以上の多孔質体である、[1]~[8]のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[10]乾燥及び/又は滅菌された[1]~[9]のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[11]エレクトロポレーション用である、[1]~[10]のいずれかに記載の多孔質基板電極体、

[12](1)電極形成用基材に、電極を形成する工程、(2)電極形成用基材に形成された電極に接触するように、多孔質体を形成する工程、(3)導電性高分子モノマーを含む電解質液中で電解重合を行い、電極から多孔質体中に導電性高分子接着層を形成させることによって、電極と多孔質体とを接着する工程、(4)電極形成用基材と、電極とを剥離する工程、を含む多孔質基板電極体の製造方法、

[13](5)電極の表面に、導電性高分子のモノマーを含む電解質液を接触させ、電解重合により、前記電極面に導電性高分子重合層を形成する工程、を更に含む[12]に記載の多孔質基板電極体の製造方法、

[14]前記電極形成用基材がガラス板であり、そして電極が金属電極、伸縮性電極、及びカーボン電極からなる群から選択される1つ以上である、[12]又は[13]に記載の多孔質基板電極体の製造方法、

[15]前記電極形成用基材がガラス板であり、そして電極が金、グラファイト、又は導電性ウレタンである、[12]~[14]のいずれかに記載の多孔質基板電極体の製造方法、

[16]前記電極形成工程(1)が、棒状の電極形成用基材の側周面に、電極を形成する工程であり、前記多孔質体の形成工程(2)が、前記電極が形成された棒状の電極形成用基材の周囲に多孔質体を形成する工程、または前記電極が形成された棒状の電極形成用基材を多孔質体に挿入する工程である、[12]~[15]のいずれかに記載の多孔質基板電極体の製造方法、

[17]前記導電性高分子のモノマーが、3,4エチレンジオキシチオフェン、アセチレン、ピロール、チオフェン、ピチオフェン、イソチオフェン、ドデシルチオフェン、イソナイトチオフェン、3-ヘキシルチオフェン、アニオン、イソチアナフテン、チアジル、フェニレン、フルオレン、ジアセチレン、アセン、パラフェニレン、チエニレンビニレン、及びフェニルスルフィドからなる群から選択される1つ以上のモノマーである、[12]~[16]のいずれかに記載の多孔質基板電極体の製造方法、及び

[18]前記多孔質体が、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、ポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギーナンゲル、キトサンゲル、ポリNイソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、ポリスチレンスルホン酸ゲル、及びそれらの2つ以上の複合ゲルからなる群から選択される1つ以上の多孔質体である、[12]~[17]に記載の多孔質基板電極体の製造方法、

10

20

30

40

50

に関する。

【発明の効果】

【0008】

本発明の多孔質基板電極体は、高電圧のパルスが発生させることができる生体親和性の高い柔軟な電極体である。従って、本発明の多孔質基板電極体は、高電圧パルスを必要とする神経又は筋肉の電気刺激に用いることができる。また、細胞への遺伝子導入のためのエレクトロポレーションに用いることもできる。また、多孔質基板電極体は、更に、体内埋め込み式の神経又は筋肉の計測制御の電極としても用いることができる。

本発明の伸縮性電極を用いた多孔質基板電極体は、伸縮性を有しているため、電極の変形が発生する箇所で使用しても、電極の断線が発生しない。例えば、本発明の多孔質基板電極体は、体表に貼って用いる診断治療器具の電極としても適している。

更に、電極が多孔質体内に埋設されている本発明の多孔質基板電極体を用いると、神経細胞や筋肉細胞の3次元培養を電気刺激下で行うことができる。特に、伸縮性電極が多孔質体内に埋設されている多孔質基板電極体の場合は、多孔質体及び電極が柔軟性を有しているため、電極の破断が生じず、前記の3次元培養を、力学刺激を加えながら行うことができる。また、体内に埋め込む圧力・ひずみセンサに用いられる可能性がある。

本発明の多孔質基板電極体を用いたエレクトロポレーションによれば、生存率を低下させることなく、付着性細胞に分子導入することができる。特に、電極表面に導電性高分子重合層を有する電極体を用いることにより、電極付近の気泡の発生及びpHの変化を防ぐことができ、細胞の生存率を上昇させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の多孔質基板電極体の製造方法（特に金電極パターンの形成）を模式的に示した図である。

【図2】本発明の多孔質基板電極体の製造方法における接着工程（導電性高分子の重合）を模式的に示した図である。

【図3】本発明の多孔質基板電極体の製造方法における電極形成工程（a）、多孔質体形成工程（b）、接着工程（c）、剥離する工程（d）を示す図である。

【図4】本発明の多孔質基板電極体の製造方法における、犠牲層（PVA）上への導電性ウレタンの溶液塗布（a）、熱処理（b）、多孔質体への接着工程（c）、剥離する工程（d）を示す図である。

【図5】実施例1で得られたポリアクリルアミドゲルと金電極による多孔質基板電極体（a）及び実施例2で得られたアガロースと金電極による多孔質基板電極体（b）の写真である。

【図6】実施例3で得られたアガロースとカーボン電極による多孔質基板電極体の写真である。

【図7】実施例4で得られたウレタン（伸縮性電極）（A）を用いた多孔質基板電極体（B）及び抵抗を測りながら行った連続伸縮試験の結果（C）である。

【図8】導電性高分子重合層を有する多孔質基板電極体の製造方法を模式的に示した図である。

【図9】実施例5で得られた導電性高分子重合層を有する金電極による多孔質基板電極体の写真（A）及びそれによる界面インピーダンスの低下のデータ（B）である。

【図10】ハイドロゲル内に電極を埋設して導電性高分子接着層で接着した多孔質基板電極体の製造方法を模式的に示した図である。

【図11】実施例5で得られたウレタン（伸縮性電極）を埋設した多孔質基板電極体の写真である。

【図12】多孔質基板電極体及び多孔質細胞保持体を用いるエレクトロポレーションの模式図（A及びB）及び写真（C）、並びに電極間の細胞の拡大写真（D）、細胞内に取り込まれたPIの蛍光を示した写真（E）、及びCalcein-AMを生細胞に取り込ませ、PI由来の赤色蛍光と、Calcein-AM由来の緑色蛍光を同時に観察した蛍光

10

20

30

40

50

写真 (F) である。

【図 1 3】多孔質基板重合電極体を用いた多孔質細胞保持体を用いるエレクトロポレーションの模式図 (A 及び B)、及び電極間の細胞の拡大写真 (C)、細胞内に取り込まれた P I の蛍光を示した写真 (D)、及び C a l c e i n - A M を生細胞に取り込ませ、P I 由来の赤色蛍光と、C a l c e i n - A M 由来の緑色蛍光を同時に観察した蛍光写真 (E) である。

【図 1 4】スピンコーター及びカッティングプロッターを用いて作成した伸縮性電極を含む多孔質基板電極体の 3 つの配線パターン (A、B、C) を示した写真である。

【図 1 5】インクジェットプリンターを用いてガラス板状に作製した 2 つの配線パターンを示した写真である。

【図 1 6】多孔質基板電極体を乾燥させ、それを水に浸漬させることによって、復元することを示した写真である。

【図 1 7】高温高圧の飽和水蒸気滅菌を行った前 (a) 及び後 (b) の導電率を示した写真及びグラフ (c) である。

【図 1 8】多孔質基板電極体の表面で筋肉細胞 (C 2 C 1 2 細胞) 及び運動神経細胞 (N G 1 0 8 - 1 5 細胞) を培養した写真である。

【図 1 9】多孔質基板電極体において、電極とハイドロゲルとが導電性高分子接着層により強固に結合していることを示す光学顕微鏡写真である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 0 】

[1] 多孔質基板電極体

本発明の多孔質基板電極体は、電極、好ましくは金属電極、カーボン電極、伸縮性電極、又はその組み合わせが、多孔質体に導電性高分子接着層によって接着しているものである。

多孔質基板電極体の導電体は、電極、好ましくは金属電極、カーボン電極、伸縮性電極、又はその組み合わせが多孔質体によってサポートされており、電極及び多孔質体が、導電性高分子接着層により強固に接着されているものである。導電性高分子接着層の高分子重合体は、多孔質体の分子と強固に絡まり結合している。また、高分子重合体は電極上に電解析出しておりその結合は強固である。

【 0 0 1 1 】

(電 極)

本発明の多孔質基板電極体に用いられる電極 (導電体) は、特に限定されるものではないが、金属電極、カーボン電極、伸縮性電極、又はそれらの複合材料電極を挙げることができる。複合材料電極としては、金属電極及びカーボン電極の組み合わせ、金属電極及び伸縮性電極の組み合わせ、又はカーボン電極及び伸縮性電極の組み合わせを挙げることができる。例えば、伸縮性電極の表面にカーボン電極であるカーボン微粒子を埋め込んだ複合材料電極を用いることができる。

【 0 0 1 2 】

(金 属 電 極)

本発明の多孔質基板電極体に含まれる金属電極は、電極として用いることのできるものである限りにおいて、特に限定されるものではない。具体的には、金、白金、チタン、アルミニウム、又はタンゲステンを挙げることができるが、好ましくは、金、又は白金である。これらの金属は、安定で生体安全性に優れるからである。また、金はガラスを電極形成用基板として製造した場合、ガラス基板から剥離しやすい点で好ましい。

金属電極の導電率 ($S / c m$) は、限定されるものではないが、 $10^3 \sim 10^6$ ($S / c m$) が好ましい。

【 0 0 1 3 】

(カ ー ボ ン 電 極)

本発明の多孔質基板電極体に含まれるカーボン電極は、電極として用いることのできるものである限りにおいて、特に限定されるものではない。具体的には、グラフェンシート

10

20

30

40

50

、カーボンナノチューブの凝集体、カーボン微粒子の凝集体、又はカーボン布を挙げる
ことができる。

【0014】

(伸縮性電極)

本発明の多孔質基板電極体に含まれる伸縮性電極は、電極として用いることのできるエ
ラストマーである限りにおいて、特に限定されるものではない。すなわち、エストラマー
に導電性が付与されてものを用いることができる。具体的には、ウレタン、シリコーンゴ
ム、フッ素ゴムを挙げるができるが、好ましくは、ウレタンである。ウレタンは、ポ
リチオフェンとの複合化によって 10^2 (S/cm) 程度の導電性を有するからである
。

10

伸縮性電極の導電率 (S/cm) は、限定されるものではないが、 $10^0 \sim 10^3$ (S/cm) が好ましい。

【0015】

金属電極及び伸縮性電極の電極パターンは、特に限定されるものではなく、それぞれの
電極の用途に応じて、適宜デザインすることができる。例えば、図5に示した電極パター
ンは、細胞に遺伝子を導入するエレクトロポレーション用の電極のパターンとして、好適
に用いることができる。

また、図11に示した電極は、キュービック状の多孔質体を中空状に貫通しているもの
である。本電極は、後述のように棒状の電極形成用基板の全面に電極パターンを形成す
ることによって得ることができる。

20

【0016】

(多孔質体)

本発明の多孔質基板電極体に含まれる多孔質体は、柔軟性を有するものである限りにお
いて、限定されるものではないが、生体親和性に優れたものが好ましく、例えばゲルを挙
げることができ、特にハイドロゲルが好ましい。

ハイドロゲルは、三次元網目構造中に溶媒として水を保持したゲルであり、非常に優れ
た吸水性を示す。天然又は合成を問わずゲルのほとんどが水を包含するので、通常ゲルと
いえばハイドロゲルを意味する。また、角膜、水晶体、硝子体、筋肉、血管、神経軸索、
又は軟骨など、生体を構成する軟組織のほとんどは生体高分子の網目構造に $60 \sim 80\%$
の水分を含む典型的なハイドロゲルである。更に、骨や歯などの硬組織に関しても、それ
自体はハイドロゲルではないが、無機物であるハイドロキシアパタイトの隙間にコラーゲ
ンなどのゲル状物質が充填された構造をとっていることが多い。従って、ハイドロゲルに
は生体由来のものや生体適合性に優れたものが数多く存在する。

30

具体的には、ハイドロゲルとしては、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナ
ンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、
フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル
、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、
ポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギ
ーナンゲル、キトサンゲル、ポリNイソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、
ポリスチレンスルホン酸ゲル又はこれらの2つ以上の混合物(複合ゲル)を挙げることは
できる。例えば、ポリアクリルアミド及びポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパ
ンスルホン酸によるダブルネットワークゲルは強靱であるため大変形が可能である。

40

多孔質体は、本発明の効果が得られる限りにおいて、多孔質体を構成する材料以外の材
料を含むことができる。具体的には、細胞、タンパク質(抗体、抗原、酵素、細胞成長因
子など)、DNAやRNAなどの核酸、ペプチド分子、マイクロ・ナノ粒子、蛍光・りん
光分子、酸化還元剤、等が挙げられる。例えば、細胞、タンパク質、ペプチド分子、核
酸を含む多孔質体は、それらを薬剤とした薬剤投与システムとして利用できる。マイクロ
・ナノ粒子は、それらを架橋点とすることで多孔質体を強靱化する。蛍光・りん光分子は、
その化学応答性を利用し多孔質体にセンサ機能を付与するのに利用できる。また、酸化還
元剤、酵素や抗体等のタンパク質は、その反応を利用した多孔質体の構造制御に利用でき

50

る。

多孔質体の含水率は、特に限定されるものではないが、60～99.5質量%が好ましく、より好ましくは70～99質量%であり、更に好ましくは80～99質量%である。

【0017】

(導電性高分子接着層)

導電性高分子接着層は、前記金属電極、カーボン電極、又は伸縮性電極と、多孔質体とを結合させている層である。導電性高分子が電極から重合により多孔質体の内部に伸長することにより、前記電極と多孔質体とを強固に結合させている(図19)。

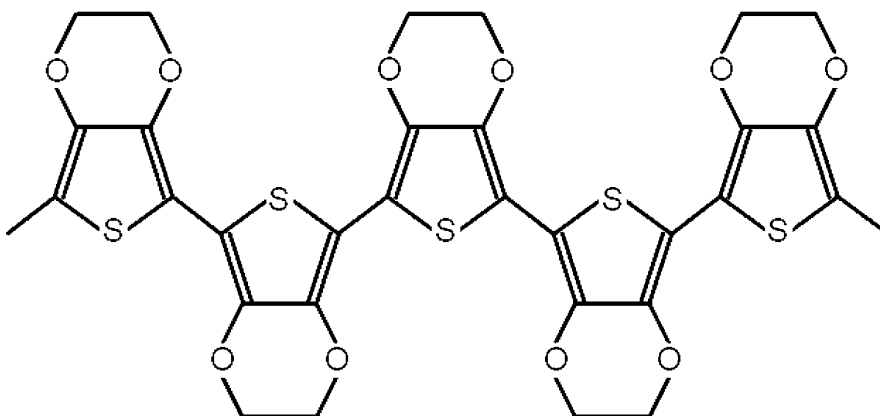
導電性高分子接着層に含まれる導電性高分子は、特に限定されるものではないが、ポリ(3,4エチレンジオキシチオフェン)(以下、PEDOTと称することがある)、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリピチオフェン、ポリイソチオフェン、ポリドデシルチオフェン、ポリイソナイトチオフェン、ポリ-3-ヘキシルチオフェン、ポリアニオン、ポリイソチアナフテン、ポリチアジル、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリジアセチレン、ポリアセン、ポリパラフェニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリフェニルスルフィド、又はその2つ以上の混合物を挙げることができ、好ましくはポリ(3,4エチレンジオキシチオフェン)、ポリピロールである。

10

【0018】

例えば、前記PEDOTは、以下の式(1)で表される化合物である。

【化1】



(1)

20

30

PEDOTは、thiopheneの3位と4位に電子供与性のアルコキシ鎖が導入されたモノマーから構成される導電性高分子である。PEDOTの重合度はそれほど大きくなく5～10くらいで、従って分子量も1000～2000程度である。しかし、導電性は重合度の高いポリアニリンやポリピロールと比較して高いという性質を有している。

【0019】

(導電性高分子重合層)

本発明の多孔質基板電極体は、電極表面に導電性高分子重合層を含んでもよい。導電性高分子重合層を有することによって、電極の分極が起こり難くなり、電気分解によるガス発生などが細胞や組織を傷害することを防ぐことができる。

本明細書において「電極表面」とは、電極が導電性高分子で接着されている導電性高分子接着層の反対側の面を意味する。

40

導電性高分子重合層に用いる導電性高分子は、前記の導電性高分子接着層に用いるものを、同様に用いることができ、具体的には、限定されるものではないが、ポリ(3,4エチレンジオキシチオフェン)、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリピチオフェン、ポリイソチオフェン、ポリドデシルチオフェン、ポリイソナイトチオフェン、ポリ-3-ヘキシルチオフェン、ポリアニオン、ポリイソチアナフテン、ポリチアジル、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリジアセチレン、ポリアセン、ポリパラフェニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリフェニルスルフィド、又はその2つ以上の混合物を挙げることができ、好ましくはポリ(3,4エチレンジオキシチオフェン)、ポリピロール、又はポリアセチレンである。

50

【 0 0 2 0 】

(乾 燥)

本発明の多孔質基板電極体は、乾燥させて体積を小さくし、それを水性液に浸漬することにより、元に体積に戻すことができる。特に、伸縮性電極を用いた多孔質基板電極体は、電極に伸縮性があるため、高い収縮率で収縮させ、そして復元させることが可能である。

【 0 0 2 1 】

(滅 菌)

本発明の多孔質基板電極体は、滅菌して用いることができる。滅菌方法としては、特に限定されるものではないが、高温高圧の飽和水蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌）、ガス滅菌、煮沸滅菌、又は薬剤（例えば、アルコール、又は次亜塩素）による滅菌、をあげることができる。これらの滅菌方法は、多孔質基板電極体の用途に応じて、適宜使い分けることができる。

実施例に示すように、オートクレーブによって滅菌した多孔質基板電極体を用いて、その表面で細胞を培養することが可能である。

【 0 0 2 2 】

[2] 多孔質基板電極体の製造方法

本発明の多孔質基板電極体の製造方法は、(1) 電極形成用基材に電極を形成する工程、(2) 電極形成用基材に形成された電極に接触するように、多孔質体を形成する工程、(3) 導電性モノマーを含む電解質液中で電解重合を行い、電極から多孔質体中に導電性高分子接着層を形成させることによって、電極と多孔質体とを接着する工程、(4) 電極形成用基材と、電極とを剥離する工程、を含み、好ましくは(5) 電極表面に、導電性モノマーを含む電解質液を接触させ、電解重合により、前記電極表面に導電性高分子重合層を形成する工程、を更に含む。

【 0 0 2 3 】

(1) 電極形成工程

(電 極 形 成 用 基 板)

電極形成用基板は、金属電極、又は伸縮性電極パターンを形成することができる限りにおいて、限定されるものではない。

素材としては、例えばガラス、プラスチック、布、又は木材を挙げることができるが、平坦であり電極との密着性が低いという点でガラスが好ましい。

電極形成用基材の形状も、限定されるものではなく、板状の基材に電極パターンを形成してもよく、棒状の基材の表面に電極パターンを形成してもよい。

【 0 0 2 4 】

(金 属 電 極)

金属電極の材料としては、前記「[1] 多孔質基板電極体」の項に記載の金属電極材料を用いることができる。

【 0 0 2 5 】

金属電極パターンの形成方法も、本技術分野における従来公知の方法を限定することなく、用いることができる。例えば、エッチング法による電極パターンの形成について、図 1 に従って説明する。

(a) スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86%エタノール IP、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄する。

(b) スパッタ蒸着装置を用いて金属（例えば、Au）を成膜する。

(c) 金属を成膜したガラス基板に、ポジ型フォトレジストをスピコート（例えば、4000rpm、30sec）する。

(d) CADなどを用いて設計した電極パターンを、レーザー描画装置を用いてエマルジョンマスクに描画し、現像してフォトマスクを得る。ガラス基板とフォトマスクを重ね、高圧水銀灯で露光（例えば、50mJ/cm²）する。

(e) 現像液を用いて現像し、蒸留水で洗浄する。

(f) ガラス基板をエッチング液(例えば、金エッチング液)に浸し、電極パターン以外の金属(Au)を除去する。

(g) アセトンを用いて、フォトレジストを除去し、ガラス基板表面に電極パターンを形成する。

なお、スライドガラスとの結合力の強い金属電極の場合は、スライドガラスに予め、ポリビニルアルコールを塗布することにより、後述の剥離を容易に行うことができる。

【0026】

(カーボン電極)

カーボン電極の材料としては、前記「[1]多孔質基板電極体」の項に記載のカーボン電極の材料を用いることができる。

カーボン電極の形成方法は、特に限定されるものではないが、以下のように形成することができる。

(a) スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86%エタノール-イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、2-プロパノール中に保管する。

(b) スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピコート(1000rpm、20秒)し、70°オープンで基板を加熱し、溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成する。

(c) スライドガラスに厚さ2mmのシリコンシートで作製した四角形の枠を設置する。

(d) グラファイト溶液を、1-メチル-2-ピロリドンに25mg/mLグラファイト粉末(粒径3μm)を添加し調製する。

(e) グラファイト溶液を200μL、前記の枠に流し込み、80°オープンで1時間溶媒を蒸発させ、その後、枠を外し、グラファイト電極パターン基板を得る。

【0027】

(伸縮性電極)

伸縮性電極の材料としては、前記「[1]多孔質基板電極体」の項に記載の伸縮性電極の材料を用いることができる。

伸縮性電極の形成方法は、特に限定されるものではない。例えば、ウレタンの形成方法は、図4のa, bに記載の様に形成することができる。

(a) スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86%エタノール-イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、2-プロパノール中に保管する。

(b) スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピコート(1000rpm、20秒)し、70°オープンで基板を加熱し、溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成する。

(c) 重合溶液を、1-ブタノールを2mL、1M EDO Tモノマー溶液を0.22mL、400mM p-トルエンスルホン酸鉄(III)含有1-ブタノール溶液を6.5mL(EDO T酸化剤、ドーパントイオン)、10重量%ポリウレタン/テトラヒドロフラン溶液を22.5mL、アニソール(溶媒の蒸発抑制用)を4.17mL混合して調製する。

(d) マイクロインジェクター(EzROBO-Ace ST4040、岩下エンジニアリング)を用いてスライドガラスに上記の重合溶液をライン形状(幅5mm、長さ10mm)に塗布し、65°のホットプレートで10分間加熱し、溶媒の蒸発と重合反応の進行を促すことで導電性ウレタンパターンを形成する。

【0028】

(2)多孔質体形成工程

多孔質体形成工程において、多孔質体は、電極形成用基材に形成された電極に接触するように形成する。多孔質体の形成は、電極が多孔質体に配設されるように形成してもよく、電極が多孔質体埋設されるように形成してもよい。また、既に形成された多孔質体を電極に接触するように配置してもよい。

多孔質体としては、前記「[1]多孔質基板電極体」の項に記載の多孔質体の材料を用

10

20

30

40

50

いることができる。

多孔質体の形成は、例えばスライドガラス上に電極パターンが形成されている場合は、その電極パターンを囲むように、シリコンシートなどで作製した枠を設置する。その枠の中に多孔質体の材料となる化合物を含む液を流しこみ、ゲル化させることによって多孔質体を形成することができる。

ゲルの含水率はそれぞれの材料によって適宜決定することが可能であり、特に限定されるものではないが、例えば60～99.5質量%が好ましく、より好ましくは70～99質量%であり、更に好ましくは80～99質量%である。

【0029】

多孔質体のゲル化は、公知の方法に従って、行うことができる。すなわち、それぞれの材料のゲル化方法に従って行うことができる。以下に、代表的な材料のゲル化方法の例を示す。

【0030】

(アガロース)

アガロースは、例えば100 で、2.8重量%程度の濃度で緩衝液に溶解し、得られたゾルを冷却することによって、40 程度でゲル化することができる。

【0031】

(グルコマンナン)

グルコマンナンは、アルカリ溶液中でゲル化する。従って、例えばグルコマンナン粉末を1.5重量%程度で水に溶解させた後、10重量%の Na_2CO_3 水溶液を、4.5重量%添加し、素早くかき混ぜ、枠に流し込む。85 で2時間加熱することによって、グルコマンナンゲルを得ることができる。

【0032】

(ポリビニルアルコール)

ポリビニルアルコール粉末を、加熱した蒸留水に加えて溶解し、10重量%の水溶液とする。その水溶液に3重量%となるようにグルタルアルデヒドを加えて十分に攪拌する。1、500rpmで3分間遠心し脱泡する。1MのHCl水溶液を1:50の割合で加えて素早く攪拌し、枠に流しこみ、12時間静置することによってゲル化することができる。

【0033】

(ポリアクリルアミド)

蒸留水にアクリルアミドとN,N'-メチレンビスアクリルアミドをそれぞれ500mg/mL、25mg/mLになるように添加し、50%(w/v)のモノーストック溶液を調整する。ストック溶液を10倍に希釈し、APS及びTEMEDを、それぞれ0.4容量%及び0.1容量%になるように添加してよく混合する。枠に流し込み、室温で2時間静置することによりゲル化することができる。

【0034】

(フィブリン)

フィブリノーゲンを任意の溶媒(水、培地、PBS等)に加え、30mg/mLの溶液とする。トロンピンを任意の溶媒(水、培地、PBS等)に加え、20Units/mLの溶液とする。枠に等量ずつ流し込み、37 で2～4時間インキュベートすることによって、ゲル化することができる。

【0035】

(3)接着工程

接着工程は、導電性モノマーを含む電解質液中で電解重合を行い、電極から多孔質体中に導電性高分子接着層を形成させることによって、電極と多孔質体とを接着する工程である。

【0036】

(導電性高分子のモノマー)

導電性高分子のモノマーとしては、前記「[1]多孔質基板電極体」の項に記載の導電

10

20

30

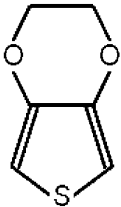
40

50

性高分子の原料となるモノマーを用いることができる。具体的には、3,4エチレンジオキシチオフェン（以下、EDOTと称することがある）、アセチレン、ピロール、チオフェン、ピチオフェン、イソチオフェン、ドデシルチオフェン、イソナイトチオフェン、3-ヘキシルチオフェン、アニオン、イソチアナフテン、チアジル、フェニレン、フルオレン、ジアセチレン、アセン、パラフェニレン、チエニレンビニレン、フェニルスルフィド、又はその混合物を挙げることができる。

例えば、前記EDOTは、下記式(2)で表される化合物である。

【化2】



(2)

10

【0037】

接着工程においては、モノマーを溶媒に溶解し、多孔質体のゲルに加え、図2に示すように電極に電位を印加することによって、導電性高分子を電解重合する。

溶媒中のモノマーの濃度は、適宜決定することができるが、例えば1~500mMで行うことができ、好ましくは10~100mMである。

電解重合で印加する電位も、適宜決定することができるが、好ましくは0.5~1.5Vである。

20

【0038】

通常、電解酸化重合は溶液中で行い、作用電極に対して重合電位を印加した瞬間から重合が開始する。しかしながら、接着工程における電解重合は、ハイドロゲル内部を導電性高分子のモノマーが拡散し、作用電極表面に到達するまでに時間がかかるため、電位の印加と重合開始とにタイムラグが生じる。例えば、厚さ2mmのアガロースを用いた場合は電位の印加から重合が開始するまでに約10分を要する。この時間はゲルの厚みや種類によって異なるため、重合量の制御はクーロンメータを用いて行うことが好ましい。

重合量は、電極と多孔質体とが実質的に結合される限りにおいて、限定されるものではないが、例えば100mC/cm²~300mC/cm²が好ましい。

30

【0039】

(4) 剥離工程

剥離工程は、電極形成用基材から電極を剥離する工程である。

例えば、金属電極としてAuを用いて、ガラス基板にAu電極パターンを形成した場合、前記接着工程におけるAu電極と多孔質体との結合力が、Au電極とガラス基板の結合よりも強いため、ガラス基板から多孔質体を剥離することによって、多孔質基板電極体をガラス基板から剥離することができる。

【0040】

また、ガラス基板との結合が強い金属電極、カーボン電極又は伸縮性電極を用いた場合は、ガラス基板に、例えばポリビニルアルコールを、予め塗布し、電極パターンを形成することによって、剥離を容易にすることができる。

40

【0041】

(5) 導電性高分子重合層形成工程

導電性高分子重合層形成工程は、電極表面に、導電性高分子のモノマーを含む電解質液を接触させ、電解重合により、前記電極表面に導電性高分子重合層を形成する工程である。

本工程では、モノマーを溶媒に溶解し、それを電極表面に接触させる。そして電極に電圧を印加することにより、電極表面に導電性高分子を重合させる。

モノマーの濃度は、適宜決定することができるが、例えば1~500mMで行うことができ、好ましくは10~100mMである。用いる容量に対する溶媒量も適宜決定するこ

50

とができる。電解重合で印加する電位も、適宜決定することができるが、好ましくは0.5～1.5Vである。本工程で使用する導電性高分子のモノマーは、前記接着工程で用いた導電性高分子のモノマーを用いることができる。

【実施例】

【0042】

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定するものではない。

《実施例1》

本実施例では、電極形成用基材としてスライドガラスを用い、多孔質体としてポリアクリルアミドを用い、そして電極材料として金を用いて多孔質基板電極体を作製した。

10

(1) 電極パターンの形成(電極形成工程)

AutoCAD 2990 (AutoDesk)を用いて電極パターンを設計した。レーザー描画装置(Heidelberg Instruments)を用い、エマルジョンマスク(2inch、FUJIFILM)にパターンを描画し、現像してフォトマスクを得た。スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86%エタノール、イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、2-プロパノール中に保管した。スパッタ蒸着装置(L-350-C、ANELVA)を用いて、Au(300nm)を成膜した。Auを成膜したガラス基板にポジ型フォトレジスト(AZ1500、38cp、AZ Electronic Materials)をスピコート(4000rpm、30sec)した、ガラス基板とフォトマスクを重ね、高圧水銀灯で露光(50mJ/cm²)した。専用現像液(AZ300MIF developer、AZ Electronic Materials)で2分間現像した後、蒸留水で洗浄(30sec×2)した。ガラス基板を金エッチング液(AURUM-302、関東化学株式会社)に浸し、電極パターン以外のAuを除去した。アセトンに浸してフォトレジストを除去し、ガラス基板表面に電極パターンを得た。

20

【0043】

(2) 多孔質体形成工程

前記電極パターンを形成したガラス基板の上に、電極パターンを囲むように厚さ2mmのシリコーンシートで作製した四角形の枠を設置した。

一方、アクリルアミド溶液は、以下のように調製した。蒸留水にアクリルアミドを500mg/mL、N,N'-メチレンビスアクリルアミドを25mg/mLになるように添加し、50%(w/v)のモノマーストック溶液を調整した。ストック溶液を10倍に希釈し、APSとTEMEDをそれぞれ0.4容量%、0.1容量%になるように添加してよく混合した。混合液を前記の枠に流し込み、室温で2時間静置することによって、アクリルアミドを重合させ、アクリルアミドゲルを形成させた。

30

【0044】

(3) 導電性高分子接着層の形成(接着工程)

蒸留水中に、EDOTモノマー50mM、及びLiClO₄(ドーバントイオン)100mMとなるように添加し、重合溶液を調整した。重合溶液を多孔質体に、0.2mL滴下し、Auの電極と重合溶液とに、1.0V(vs. Ag/AgCl)の電位を印加して、重合量300mC/cm²、電解酸化重合を行った。

40

【0045】

(4) 剥離工程

PEDOT重合の終了後に、アクリルアミドゲルを基板から剥離し、金がパターンニングされたアクリルアミドゲル基板電極体を得た。

得られた多孔質基板電極体を図5(a)に示す。

【0046】

《実施例2》

本実施例では、電極形成用基板としてスライドガラスを用い、多孔質体としてアガロースを用い、そして電極材料として金を用いて多孔質基板電極体を作製した。

50

多孔質体として、アクリルアミドに代えてアガロースを用いてことを除いて、実施例 1 の操作を繰り返した。アガロース多孔質体形成工程は、以下の通り行った。

【0047】

(2) 多孔質体形成工程

前記電極パターンを形成したガラス基板の上に、電極パターンを囲むように厚さ 2 mm のシリコンシートで作製した四角形の枠を設置した。

一方、アガロース溶液は、以下のように調製した。蒸留水にアガロース粉末を 2 . 8 重量%になるように添加し、100 で加熱溶解し、アガロースのゾルを調整した。アガロースのゾルを前記の枠に流し込み、40 以下まで冷却することによって、アガロースゲルを形成させた。

得られた多孔質基板電極体を図 5 (b) に示す。

【0048】

《実施例 3》

本実施例では、電極形成用基板としてスライドガラスを用い、多孔質体としてアガロースを用い、そして電極材料としてグラファイトを用いて多孔質基板電極体を作製した。

(1) 電極パターンの形成 (電極形成過程)

スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86%エタノール - イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、2 - プロパノール中に保管した。スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピンコート (1000 rpm、20秒) した。70 オープンで基板を加熱し、溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成した。

スライドガラスに厚さ 2 mm のシリコンシートで作製した四角形の枠を設置した。グラファイト溶液は、1 - メチル - 2 - ピロリドンに 25 mg / mL グラファイト粉末 (粒径 3 μ m) を添加し調製した。前記のグラファイト溶液を 200 μ L、前記の枠に流し込み、80 オープンで1時間溶媒を蒸発させた。その後、枠を外し、グラファイト電極パターン基板を得た。

【0049】

(2) 多孔質体形成工程

スライドガラス上に、厚さ 2 mm のシリコンシートで作製した四角形の枠を設置した。一方、アガロース溶液は、以下のように調製した。蒸留水にアガロース粉末を 2 . 8 重量%になるように添加し、100 で加熱溶解し、アガロースのゾルを調製した。アガロースのゾルを前記の枠に流し込み、40 以下まで冷却することによって、アガロースゲルを形成した。

【0050】

(3) 導電性高分子接着層の形成

重合溶液は、蒸留水中に E D O T モノマーを 50 mM、及び LiClO₄ (ドーパントイオン) を 100 mM となるように添加し、調製した。前記のアガロースゲルは適当なサイズに切り分け、重合溶液に 30 分浸漬した。

前記のアガロースゲルをグラファイト電極パターン上に貼り、重合溶液を 0 . 2 mL 滴下した。グラファイトの電極と重合溶液とに 1 . 2 V (v s . A g / A g C l) の電位を印加して、重合量 300 mC / cm²、電解酸化重合を行った。

【0051】

(4) 剥離工程

P E D O T 重合終了後、基板を室温の蒸留水に 5 分間浸漬し、ポリビニルアルコール犠牲層を溶解させた。アガロースゲルを基板から剥離し、グラファイト電極がパターンされたアガロースゲル基板電極体を得た。

得られた多孔質基板電極体を図 6 に示す。

【0052】

《実施例 4》

本実施例では、電極形成用基板としてスライドガラスを用い、多孔質体としてポリ 2 -

10

20

30

40

50

アクリルアミド - 2 - メチルプロパンスルホン酸 (PAMPS) ゲルとポリアクリルアミドゲルから成るダブルネットワークゲルを用い、そして電極材料として導電性ウレタンを用いて多孔質基板電極体を作製した。

(1) 電極パターンの形成 (電極形成工程)

スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86% エタノール - イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、イソプロパノール中に保管した。スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピコート(1000rpm、20秒)し、70℃オープンを用いた基板の加熱により溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成した。

重合溶液は、1-ブタノールを2mL、1M EDO Tモノマー溶液を0.22mL、400mM p-トルエンスルホン酸鉄(III)含有1-ブタノール溶液を6.5mL (EDO T酸化剤、ドーパントイオン)、10重量%ポリウレタン/テトラヒドロフラン溶液を22.5mL、アニソール(溶媒の蒸発抑制用)を4.17mL混合して調製した。マイクロインジェクター(EzROBO-Ace ST4040、岩下エンジニアリング)を用いてスライドガラスに上記の重合溶液をライン形状(幅5mm、長さ10mm)に塗布した。65℃のホットプレートで10分間加熱し、溶媒の蒸発と重合反応の進行を促すことで導電性ウレタンパターンを形成した。

【0053】

(2) 多孔質体形成工程

2種類のモノマー溶液は、以下のように調整した。モノマー溶液1は、蒸留水に2-アクリルアミド - 2 - メチルプロパンスルホン酸を1M、N,N'-メチレンビスアクリルアミドを40mM、APSを0.9mM、2-オキソグルタル酸(光重合開始剤)を2mMになるように添加し、よく混合した。モノマー溶液2は、蒸留水にアクリルアミドを1M、N,N'-メチレンビスアクリルアミドを1mM、APSを0.4mM、2-オキソグルタル酸を0.5mMになるように添加し、よく混合した。

スライドガラスに厚さ0.5mmのシリコンシートで作製した四角形の枠を設置した。前記のモノマー溶液1を前記の枠に流し込み、スライドガラスで蓋をした状態で紫外線(波長256nm、出力8W)を室温で6時間照射しゲル化した。得られたゲルを前記のモノマー溶液2に浸漬し、遮光した状態で4℃で24時間、モノマー溶液2をゲルに染み込ませた。その後、再度紫外線(波長256nm、出力8W)を室温で6時間照射し、モノマー溶液2を重合することでダブルネットワークゲルを得た。

【0054】

(3) 導電性高分子接着層の形成 (接着工程)

ダブルネットワークゲルを前記の導電性ウレタンパターン基板に設置した。重合溶液は、蒸留水中に、EDO Tモノマーを50mM、LiClO₄(ドーパントイオン)を100mMとなるように添加して調製した。重合溶液を多孔質体に0.5mL滴下し、導電性ウレタンと重合溶液に、1.2V(vs. Ag/AgCl)の電位を印加して、重合量300mC/cm²、電解酸化重合を行った。

【0055】

(4) 剥離工程

PEDO T重合後、基板を100℃の蒸留水に30分間浸漬し、ポリビニルアルコール犠牲層を溶解させた。ダブルネットワークゲルを基板から剥離し、導電性ウレタンがパターンニングされたダブルネットワークゲル基板電極体を得た。

得られた多孔質基板電極体を伸縮実験の結果を図7(b)に示す。

【0056】

《実施例5》

本実施例では、金を電極材料とした多孔質基板電極体を用い、電極表面を導電性高分子PEDO Tで被覆した。実施例1、あるいは実施例2の工程後に以下の操作を行った。

(1) 導電性高分子重合層形成工程

重合溶液は、蒸留水中にEDO Tモノマーを50mM、及びLiClO₄(ドーパント

10

20

30

40

50

イオン)を100mM添加して調製した。重合溶液を多孔質基板電極体のAu電極表面に100 μ L滴下し、電極と重合溶液とに1.0V(vs. Ag/AgCl)の電位を印加して、重合量150mC/cm²、電解酸化重合を行い、導電性高分子重合層を電極表面に形成した。

得られた多孔質基板重合電極体を図9(a)に示す。

【0057】

(2)インピーダンス計測

前記の多孔質基板電極体のACインピーダンススペクトルを、0.1MのLiClO₄水溶液中で \pm 5mVの強度で測定した。結果を図9(b)に示す。

【0058】

《実施例6》

本実施例では、電極形成用基板としてスライドガラスと針を用い、多孔質体としてダブルネットワークゲルを用い、そして電極材料として導電性ウレタンを用いて多孔質基板電極体を作製した。

(1)電極パターンの形成(電極形成工程)

スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86%エタノール-イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、イソプロパノール中に保管した。スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピンコート(1000rpm、20秒)し、70 $^{\circ}$ Cオープンを用いた基板の加熱により溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成した。

重合溶液は、実施例4(1)記載の溶液を使用した。マイクロインジェクター(EzROBO-AceST4040、岩下エンジニアリング)を用いて前記のスライドガラスに重合溶液を1cm角の四角形に塗布した。65 $^{\circ}$ Cのホットプレートで10分間加熱し、溶媒の蒸発と重合反応の進行を促すことで導電性ウレタンを得た。

基板を100 $^{\circ}$ Cの蒸留水に30分浸漬し、ポリビニルアルコール犠牲層を溶解させ、導電性ウレタンを基板から剥離した。直径1.4mmの針に5重量%のポリビニルアルコール溶液を犠牲層としてディップコートした後、前記の導電性ポリウレタンを巻き付け、針状導電性ポリウレタンを得た。

【0059】

(2)導電性高分子接着層の形成(接着工程)

多孔質体は、実施例4(2)記載のダブルネットワークゲルを用いた。重合溶液は、蒸留水中に、EDOTモノマー50mM、及びLiClO₄(ドーパントイオン)100mMとなるように添加して調製した。前記の針状導電性ウレタンをダブルネットワークゲルに刺した状態で重合溶液に浸漬し、針と重合溶液とに、1.2V(vs. Ag/AgCl)の電位を印加して、重合量300mC/cm²、電解酸化重合を行った。

【0060】

(3)剥離工程

PEDOT重合後、多孔質体を100 $^{\circ}$ Cの蒸留水に30分浸漬し、ポリビニルアルコール犠牲層を溶解させ、導電性ウレタンを針から剥離した。針を多孔質体から抜き、ダブルネットワークゲル基板電極体を得た。

得られたキュービック状の多孔質基板電極体の圧縮実験の結果を図11に示す。

【0061】

《参考例1》

本参考例では、実施例1で得られた多孔質体基板電極体及び多孔質細胞保持体を用いて蛍光試薬Propidium Iodide(PI)をエレクトロポレーションで導入した。PIは細胞膜不透過性の蛍光試薬である。

(1)細胞ゲルシートの作製(細胞保持体取得工程)

FBM培地にフィブリノーゲンとアプロチニンをそれぞれ30mg/mL及び1mg/mLになるように添加し、フィブリノーゲン溶液を調整した。FBM培地にトロンピンを20Units/mLになるように添加し、トロンピン溶液を調整した。

10

20

30

40

50

正常ヒト皮膚線維芽細胞NHDF-Neo株を、培養用培地(FBM培地(タカタバイオ株式会社)500mLに、hFGF-Bを0.5mL、FBSを10mL、GA-100(50mg/mLゲンタマイシン及び50µg/mLアンホテリシンB)を0.5mL添加)を用いて、24ウェルプレートで、コンフルエントになるまで培養した。細胞を傷つけないように注意しながらプレート内の培地を抜いた。ピペットを用いてPBS(-)を静かに注ぎ、細胞を洗浄した。PBS(-)を抜いた後、細胞上に前記のフィブリノーゲン溶液及びトロンピン溶液を等量添加した。4時間、37℃でインキュベートし、ゲル化およびゲル表面への細胞の付着を促した。細胞培養基板(24ウェルプレート)からフィブリンゲルを剥離し、細胞が表面に固定化され多孔質細胞保持体(細胞ゲルシート)を得た。

10

【0062】

(2) PIの導入(導入工程)

PI溶液は、エレクトロポレーション用バッファ(Hyposmolar buffer、eppendorf)にPIを1.0mg/mLになるように添加することによって作製した。得られたPI溶液は、使用までアルミホイルで遮光して37℃のウォーターバス内で保温した。

前記参考例1で得られた多孔質体基板電極体(ハイドロゲル基板電極)を、FBM培地(タカラバイオ株式会社)に浸漬し、37℃で2時間インキュベートした。多孔質体基板電極体上に、前記PI溶液を、数滴、滴下した。その上から、前記工程(1)で得られた多孔質細胞保持体(細胞ゲルシート)の細胞面が、多孔質体基板電極体の電極面に密着するように貼り合わせた。エレクトロポレーター(CUY21EDITII、株式会社ベックス)電極体の金電極に接続し、80V、0.1msec、及び30パルス(1Hz周期)の条件で、電気パルスを印加した。

20

生細胞を染色するために、細胞ゲルシート上からCalcein-AM溶液を滴下し、インキュベータ内で1時間培養した。蛍光顕微鏡を用いて細胞の蛍光観察を行い、PIの取り込みの評価と生細胞判定を行った。結果を図12に示す。

【0063】

図12(E)に示すように、電極間の細胞にPI由来の赤色蛍光が観察され、PIが細胞内に取り込まれたことが分かる。図12(F)は、Calcein-AMを生細胞に取り込ませ、PI由来の赤色蛍光と、Calcein-AM由来の緑色蛍光を同時に観察した蛍光写真である。電極と電極の中間に位置する細胞に、赤色蛍光及び緑色蛍光が確認され、生細胞にPIを導入されたことが分かる。

30

但し、電極付近の細胞、及び図12(D)に見られる気泡に近い細胞は、緑色蛍光が弱く、死細胞であると考えられる。細胞の生存率は約50%程度であった。

【0064】

《参考例2》

本参考例では、実施例5で製造した、多孔質基板重合電極体を用いて、付着細胞へのPIの導入を行った。

実施例1で製造された多孔質基板電極体に代えて、実施例5で製造された多孔質基板重合電極体を用いたこと、及びパルス条件を60V、0.1msec、及び30パルス(1Hz周期)としたことを除いては、参考例1の操作を繰り返した。結果を図13に示す。

40

電極間の細胞にPI由来の赤色蛍光が観察され、PIが細胞内に取り込まれた。また図13(C)の写真から分かるように電極付近での、気泡の発生がなかった。また、図13(E)は、Calcein-AMを生細胞に取り込ませ、PI由来の赤色蛍光とCalcein-AM由来の緑色蛍光を同時に観察した蛍光写真である。PIが導入された細胞のほとんどが生細胞であった。生存率は80%を超えていた。すなわち、多孔質基板重合電極体を用いることにより、細胞の生存率を更に上昇させることができる。

【0065】

《実施例7》

本実施例では、電極形成用基板としてスライドガラスを用い、多孔質体としてポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸(PAMPS)ゲルとポリアクリルアミドゲ

50

ルから成るダブルネットワークゲルを用い、そして電極材料として導電性ウレタンを用いて多孔質基板電極体を作製した。電極パターンは、スピンコーター及びカッティングプロッターを用いて作製した。

(1) 電極パターンの形成 (電極形成工程)

スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86% エタノール-イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、イソプロパノール中に保管した。スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピンコート(1000rpm、20秒)し、70° オープンを用いた基板の加熱により溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成した。

重合溶液(EDOT/PU溶液)は、1-ブタノールを2mL、1M EDOTモノマー溶液を0.22mL、400mM p-トルエンスルホン酸鉄(III)含有1-ブタノール溶液を6.5mL(EDOT酸化剤、ドーパントイオン)、10重量%ポリウレタン/テトラヒドロフラン溶液を22.5mL、アニソール(溶媒の蒸発抑制用)を4.17mL混合して調製した。スピンコーターを用いてスライドガラスに上記の重合溶液を、750rpm、30秒で塗布した。100° のホットプレートで10分間加熱し、溶媒の蒸発と重合反応の進行を促すことで導電性ウレタン(PEDOT/PU)の薄膜を形成した。

カッティングプロッター(Craft ROBO Pro, Graphtec, Japan)で所望のパターンを切り出した。PEDOT/PU薄膜の余分な部分は水中でピンセットを用いて除去し、PEDOT/PUの配線パターンを得た。

【0066】

実施例4の「(2)多孔質体形成工程」、「(3)導電性高分子接着層の形成(接着工程)」、及び「(4)剥離工程」の操作を繰り返して、多孔質基板電極体を得た(図14)。

【0067】

《実施例8》

本実施例では、電極形成用基板としてスライドガラスを用い、インクジェットプリンターを用いて電極パターンの作製を行った(図15)。

(1) 電極パターンの形成 (電極形成工程)

スライドガラスを適当なサイズに切り分け、アセトン、86% エタノール-イソプロパノール、蒸留水の順で15分ずつ超音波洗浄し、イソプロパノール中に保管した。スライドガラスに10重量%のポリビニルアルコール水溶液をスピンコート(1000rpm、20秒)し、70° オープンを用いた基板の加熱により溶媒を蒸発させてポリビニルアルコール犠牲層を形成した。

重合溶液(EDOT/PU溶液)は、1-ブタノールを2mL、1M EDOTモノマー溶液を0.22mL、400mM p-トルエンスルホン酸鉄(III)含有1-ブタノール溶液を6.5mL(EDOT酸化剤、ドーパントイオン)、10重量%ポリウレタン/テトラヒドロフラン溶液を22.5mL、アニソール(溶媒の蒸発抑制用)を4.17mL混合して調製した。インクジェットプリンター(SIJ Technology, PR150)にEDOT/PU溶液を充填し、100° のホットプレート上のスライドガラス上へ、配線パターンを描画し、PEDOT/PUの配線パターンを得た。

【0068】

《実施例9》

本実施例では、実施例7で得られた多孔質基板電極体の乾燥を行った。

多孔質基板電極体を25° の空気中で、12時間放置して乾燥させた。多孔質基板電極体は1/4の体積に縮んだ。乾燥した多孔質基板電極体を水に浸漬することによって、5分で元の体積に回復した(図16)。多孔質基板電極体の電極の剥離は起こらなかった。また、通電を行ったところ、抵抗の上昇も見られなかった。

【0069】

《実施例10》

10

20

30

40

50

本実施例では、実施例 7 で得られた多孔質基板電極体の滅菌を行った。

多孔質基板電極体を、高温高压（121℃，2気圧）の飽和水蒸気で20分間の加熱処理を行った。多孔質基板電極体の電極の剥離は起こらなかった。また、滅菌前の多孔質基板電極体（図17a）及び滅菌前の多孔質基板電極体（図17b）で、導電率は変化しなかった（図17c）。

【0070】

《実施例11》

本実施例では、実施例10で滅菌した多孔質基板電極体上で、細胞培養を行った。

多孔質基板電極体の表面でC2C12細胞（筋肉細胞）又はNG108-15細胞（運動神経細胞）の培養を行い、その電極表面への接着性を評価した。結果を図18に示す。細胞吸着タンパク質や接着因子を用いていないにも拘らず、どちらの細胞もほぼ全く死滅することなく多孔質基板電極体の表面で接着及び増殖していた。また、この培養状態を数日間維持し続けても、死細胞の増加は観察されなかった。従って、本発明の多孔質基板電極体は、細胞に対して優れた生体適合性（非毒性）を有していた。図の矢印で示した通り、神経細胞の場合には隣接する細胞へ向かって神経突起を長く伸ばす様子も確認でき、多孔質基板電極体が細胞間相互作用に対しても非常に有利な基板として利用可能であることも同時に分かった。

10

【0071】

《導電性高分子接着層の撮影》

実施例7で得られた多孔質基板電極体の電極と、ハイドロゲルとの界面を光学顕微鏡で撮影した。図19に示すように電極と、ハイドロゲルとが、導電性高分子接着層によって、強固に接着していることがわかった。

20

【産業上の利用可能性】

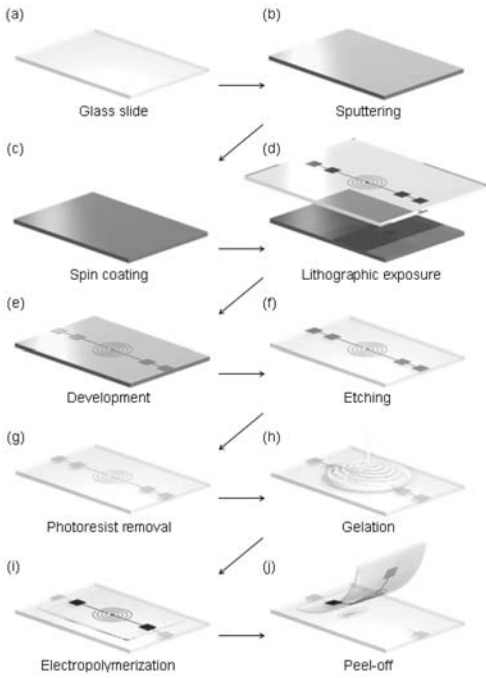
【0072】

本発明の多孔質基板電極体は、エレクトロポレーション用の電極、体表に貼って用いる診断治療器具の電極、体内埋め込み式の神経又は筋肉の計測制御の電極、神経又は筋肉細胞の培養用の電極、又は体内に埋め込む圧力・ひずみセンサの電極として用いることができる。

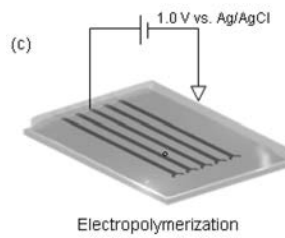
以上、本発明を特定の態様に沿って説明したが、当業者に自明の変形や改良は本発明の範囲に含まれる。

30

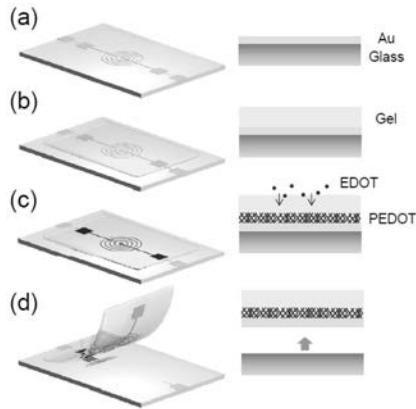
【 図 1 】



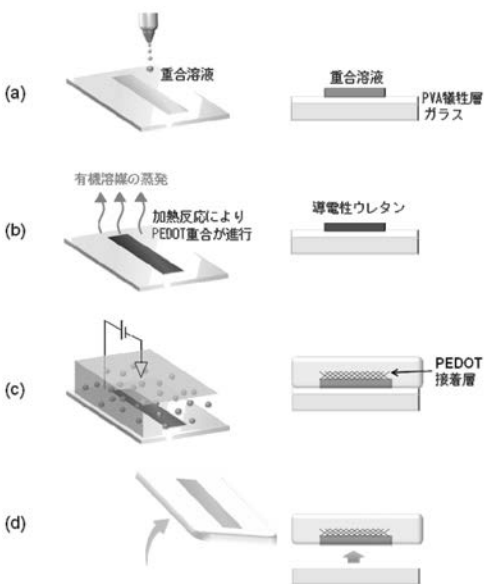
【 図 2 】



【 図 3 】



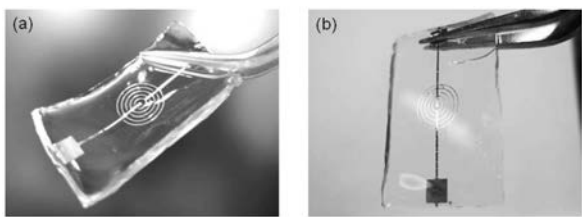
【 図 4 】



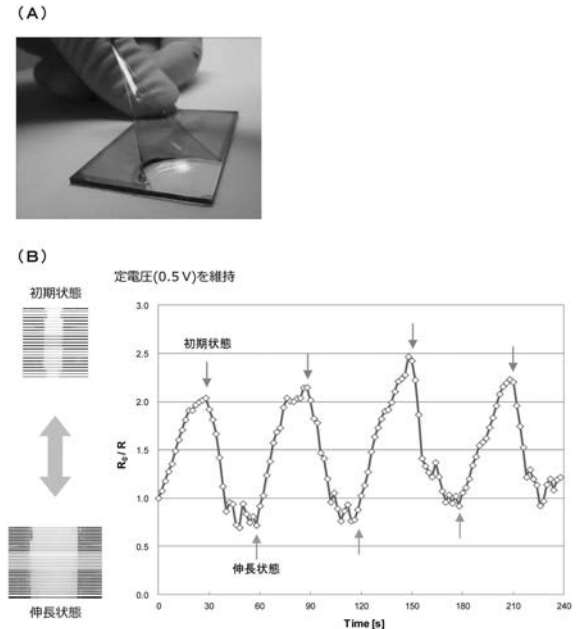
【 図 6 】



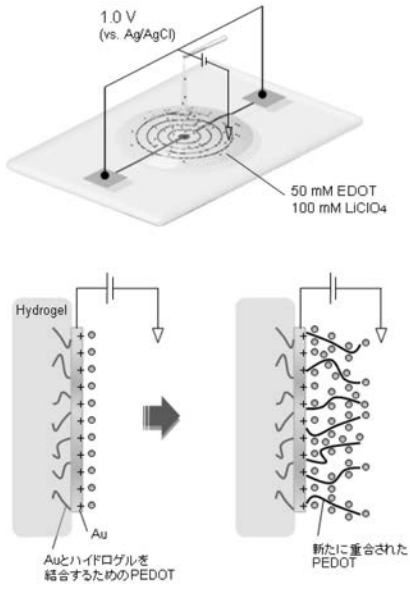
【 図 5 】



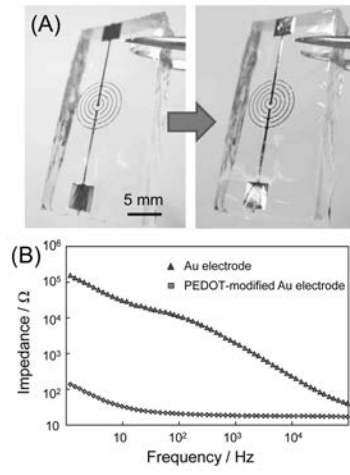
【 図 7 】



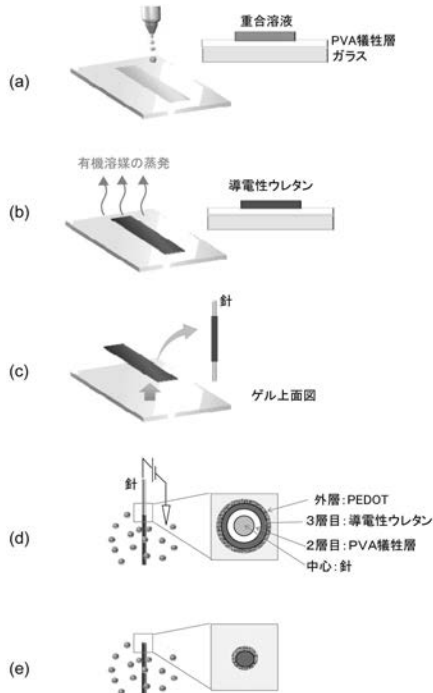
【 図 8 】



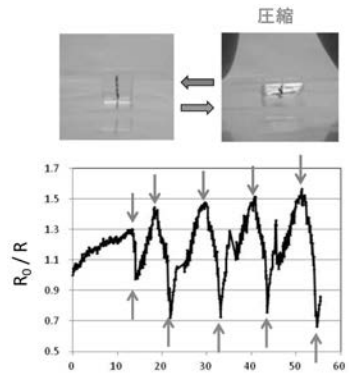
【 図 9 】



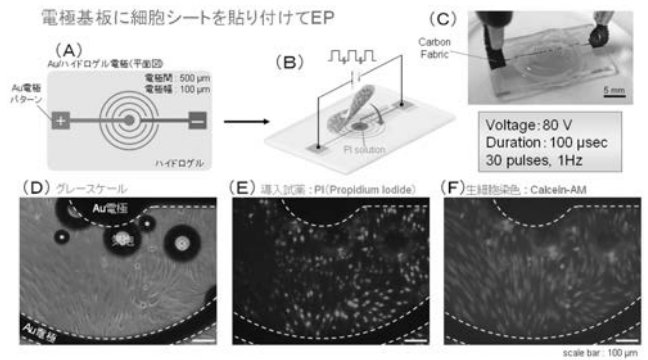
【 図 10 】



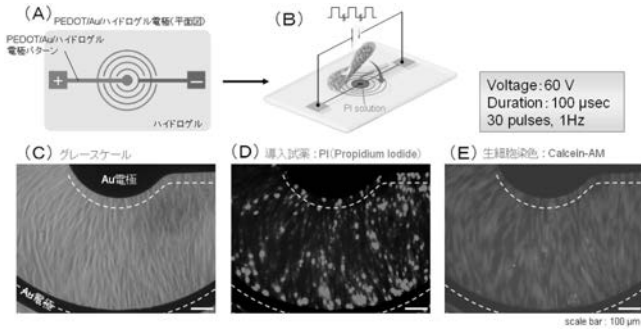
【 図 11 】



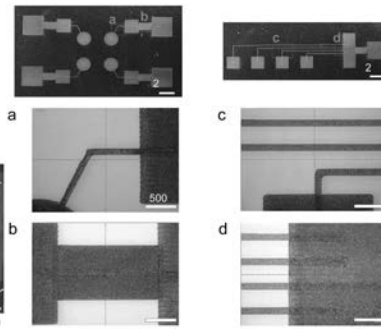
【 図 12 】



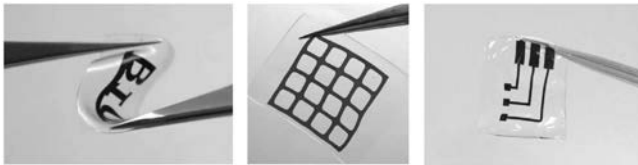
【 図 1 3 】



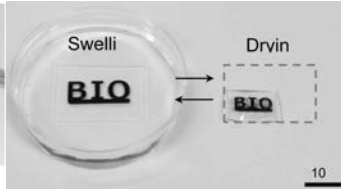
【 図 1 5 】



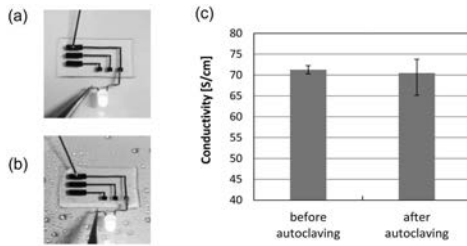
【 図 1 4 】



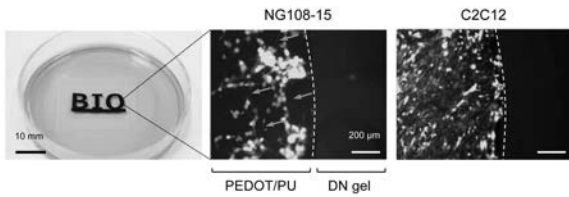
【 図 1 6 】



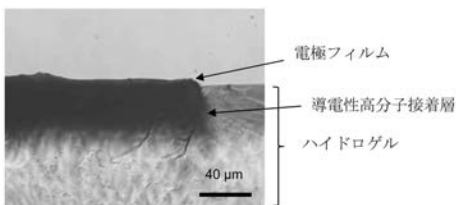
【 図 1 7 】



【 図 1 8 】



【 図 1 9 】



【手続補正書】

【提出日】平成26年12月24日(2014.12.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電極が、多孔質体に導電性高分子を含む接着層によって接着していることを特徴とする多孔質基板電極体。

【請求項2】

前記接着層が、電極から多孔質体に導電性高分子が伸長した接着層である、請求項1に記載の多孔質基板電極体。

【請求項3】

前記電極が、金属電極、伸縮性電極、カーボン電極及びそれらの複合材料電極からなる群から選択される1つ以上である請求項1又は2に記載の多孔質基板電極体。

【請求項4】

前記電極が、金、グラファイト、又は導電性ウレタンである、請求項1～3のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項5】

電極が多孔質体上への配設、又は多孔質体内への埋設によって、接着している請求項1～4のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項6】

前記電極の表面に、更に導電性高分子重合層を有する請求項1～5のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項7】

前記導電性高分子が、ポリ(3,4エチレンジオキシチオフエン)、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフエン、ポリピチオフエン、ポリイソチオフエン、ポリドデシルチオフエン、ポリイソナイトチオフエン、ポリ-3-ヘキシルチオフエン、ポリアニオン、ポリイソチアナフテン、ポリチアジル、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリジアセチレン、ポリアセン、ポリパラフェニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリフェニレスルフィドからなる群から選択される1つ以上の導電性高分子である、請求項1～6のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項8】

前記多孔質体がゲルである請求項1～7のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項9】

前記多孔質体がハイドロゲルである請求項1～8のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項10】

前記多孔質体が、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、ポリ2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギーナンゲル、キトサンゲル、ポリNイソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、ポリスチレンスルホン酸ゲル、及びそれらの2つ以上の複合ゲルからなる群から選択される1つ以上の多孔質体である、請求項1～9のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項11】

乾燥及び/又は滅菌された請求項1～10のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 1 2】

エレクトロポレーション用である、請求項 1 ~ 1 1 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体。

【請求項 1 3】

(1) 電極形成用基材に、電極を形成する工程、
(2) 電極形成用基材に形成された電極に接触するように、多孔質体を形成する工程、
(3) 導電性高分子モノマーを含む電解質液中で電解重合を行い、電極から多孔質体中に導電性高分子接着層を形成させることによって、電極と多孔質体とを接着する工程、
(4) 電極形成用基材と、電極とを剥離する工程、
を含む多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 1 4】

(5) 電極の表面に、導電性高分子のモノマーを含む電解質液を接触させ、電解重合により、前記電極面に導電性高分子重合層を形成する工程、を更に含む請求項 1 3 に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 1 5】

前記電極形成用基材がガラス板であり、そして電極が金属電極、伸縮性電極、及びカーボン電極からなる群から選択される 1 つ以上である、請求項 1 3 又は 1 4 に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 1 6】

前記電極形成用基材がガラス板であり、そして電極が金、グラファイト、又は導電性ウレタンである、請求項 1 3 ~ 1 5 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 1 7】

前記電極形成工程 (1) が、棒状の電極形成用基材の側周面に、電極を形成する工程であり、

前記多孔質体の形成工程 (2) が、前記電極が形成された棒状の電極形成用基材の周囲に多孔質体を形成する工程、または前記電極が形成された棒状の電極形成用基材を多孔質体に挿入する工程である、請求項 1 3 ~ 1 6 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 1 8】

前記導電性高分子のモノマーが、3, 4 エチレンジオキシチオフエン、アセチレン、ピロール、チオフエン、ピチオフエン、イソチオフエン、ドデシルチオフエン、イソナイトチオフエン、3 - ヘキシルチオフエン、アニオン、イソチアナフテン、チアジル、フェニレン、フルオレン、ジアセチレン、アセン、パラフェニレン、チエニレンビニレン、及びフェニルスルフィドからなる群から選択される 1 つ以上のモノマーである、請求項 1 3 ~ 1 7 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【請求項 1 9】

前記多孔質体が、アガロースゲル、コラーゲンゲル、グルコマンナンゲル、ポリアクリルアミドゲル、ポリアクリルアミド - 2 - メチルプロパンスルホン酸、フィブリンゲル、ポリビニルアルコールゲル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートゲル、シリコーンハイドロゲル、ポリビニルピロリドンゲル、ポリエチレングリコールゲル、ポリ 2 - アクリルアミド - 2 - メチルプロパンスルホン酸ゲル、アルギン酸ゲル、カラギーナンゲル、キトサンゲル、ポリ N イソプロピルアクリルアミドゲル、アクリル酸ゲル、ポリスチレンスルホン酸ゲル、及びそれらの 2 つ以上の複合ゲルからなる群から選択される 1 つ以上の多孔質体である、請求項 1 3 ~ 1 8 のいずれか一項に記載の多孔質基板電極体の製造方法。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2014/058947
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61N1/04(2006.01) i, C08J9/42(2006.01) i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61N1/04, C08J9/42 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2014 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2014 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2014 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	WO 2012/124216 A1 (Sekisui Plastics Co., Ltd.), 20 September 2012 (20.09.2012), paragraphs [0033], [0051], [0054]; fig. 2 (Family: none)	1-4, 7-11 5 6, 12-18
Y A	JP 2008-136684 A (Tohoku University), 19 June 2008 (19.06.2008), paragraphs [0002], [0007], [0011] (Family: none)	5 1-4, 6-18
A	WO 2008/096332 A1 (COMPEX MEDICAL S.A.), 14 August 2008 (14.08.2008), entire text; all drawings (Family: none)	1-18
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 13 June, 2014 (13.06.14)		Date of mailing of the international search report 24 June, 2014 (24.06.14)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/058947

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2011/118800 A1 (Tohoku University), 29 September 2011 (29.09.2011), paragraphs [0021] to [0030]; fig. 1, 2 & US 2013/0126220 A1 & EP 2554365 A1	1-18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/058947

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
(See extra sheet.)

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/058947

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

Document 1 (WO2012/124216A1 (Sekisui Plastics Co., Ltd.), 20 September 2012 (20.09.2012), paragraphs [0033], [0051], [0054], fig. 2) sets forth a porous substrate electrode body of the invention of claims 1-4 of this international application. Consequently, the invention of claims 1-4 does not have a special technical feature since it is not novel over document 1.

Next, a special technical feature was found in the invention of claim 5.

Accordingly, claims are classified into two inventions each of which has a special technical feature indicated below.

Meanwhile, the inventions of claims 1-4 having no special technical feature are classified into Invention 1.

(Invention 1) claims 1-11:

A porous substrate electrode body wherein an electrode is bonded to a porous body by means of a conductive polymer adhesive layer and the surface of the electrode is provided with a conductive polymer polymerized layer.

(Invention 2) claims 12-18:

A method for producing a porous substrate electrode body, which comprises a step wherein an electrode and a porous body are bonded with each other by performing an electropolymerization in an electrolyte solution containing a monomer for a conductive polymer so that a conductive polymer adhesive layer is formed from the electrode into the porous body.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2014/058947									
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61N1/04(2006.01)i, C08J9/42(2006.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61N1/04, C08J9/42											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2014年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2014年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2014年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2014年	日本国実用新案登録公報	1996-2014年	日本国登録実用新案公報	1994-2014年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2014年										
日本国実用新案登録公報	1996-2014年										
日本国登録実用新案公報	1994-2014年										
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
X Y A	WO 2012/124216 A1 (積水化成工業株式会社) 2012.09.20, [0033], [0051], [0054], 第2図 (ファミリーなし)	1-4, 7-11 5 6, 12-18									
Y A	JP 2008-136684 A (国立大学法人東北大学) 2008.06.19, 【0002】, 【0007】, 【0011】 (ファミリーなし)	5 1-4, 6-18									
A	WO 2008/096332 A1 (COMPEX MEDICAL S.A.) 2008.08.14, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-18									
C欄の続きにも文献が列挙されている。		パテントファミリーに関する別紙を参照。									
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献									
国際調査を完了した日 13.06.2014		国際調査報告の発送日 24.06.2014									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 佐藤 智弥	3 I 3735								
		電話番号 03-3581-1101 内線 3386									

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2014/058947
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2011/118800 A1 (国立大学法人東北大学) 2011.09.29, [0021]-[0030], 第 1, 2 図 & US 2013/0126220 A1 & EP 2554365 A1	1-18

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 5 8 9 4 7

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. 請求項 _____ は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。つまり、
2. 請求項 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求項 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
(別紙参照)

1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。
- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。
- 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉(2)) (2009年7月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 4 / 0 5 8 9 4 7

文献1(WO 2012/124216 A1(積水化成工業株式会社) 2012.09.20, [0033], [0051], [0054], 第2図)には、請求項1乃至4に係る発明の多孔質基板電極体が記載されており、請求項1乃至4に係る発明は、文献1により新規性が欠如しているため、特別な技術的特徴を有しない。次に、請求項5に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。そして、請求の範囲は、各々下記の特別な技術的特徴を有する2の発明に区分される。

なお、特別な技術的特徴を有しない請求項1乃至4に係る発明は、発明1に区分する。

(発明1) 請求項1-11: 電極が多孔質体に導電性高分子接着層によって接着し、電極の表面に導電性高分子重合層を有する多孔質基板電極体。

(発明2) 請求項12-18: 導電性高分子モノマーを含む電解質液中で電解重合を行い、電極から多孔質体中に導電性高分子接着層を形成させることによって、電極と多孔質体とを接着する工程を含む多孔質基板電極体の製造方法。

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(出願人による申告)平成24年度、国立研究開発法人科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業(CREST)委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。